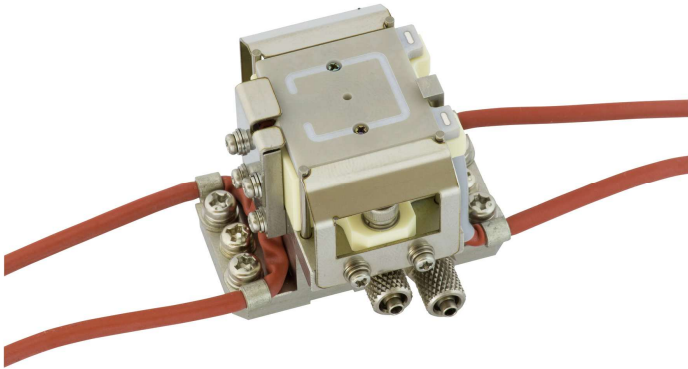
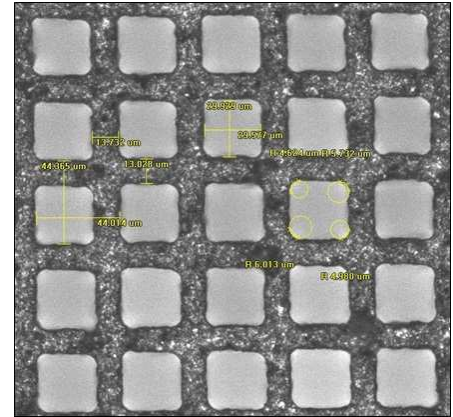
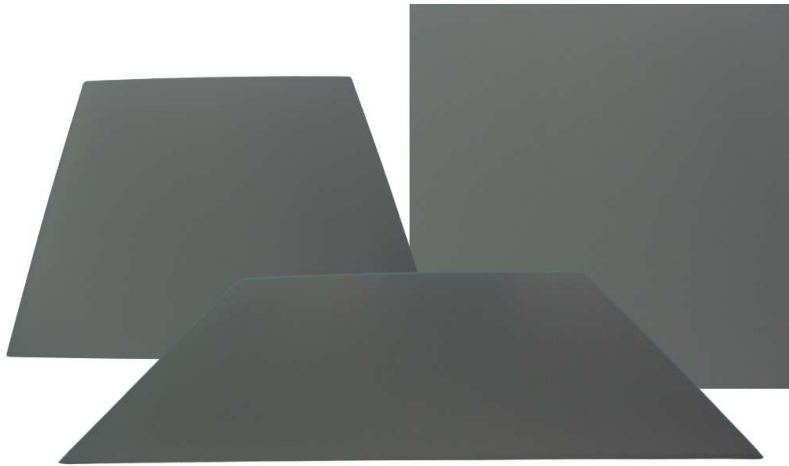




Ceramics

Prober, Probe Card, Socket, Tester, TCBondhing



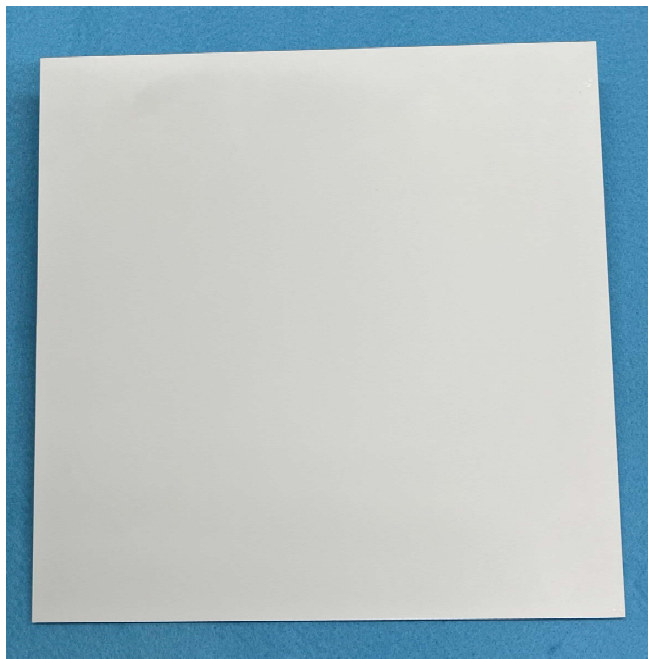
品名	特徴	密度 g/cm ³	弾性率 Gpa	曲げ強度 Mpa	ビッカース硬度 HV	熱膨張係数 X10 ⁻⁶ /K	熱伝導率 W/m・K	電気抵抗 Ω・cm	標準サイズ	MAX
LAD-D1	低熱膨張 & 断熱	2.60	110	200	4.5	4.7	2.6	10 ¹²	130角X22 t	160角X22 t
LAD-D3	超低熱膨張 & 断熱	2.30	90	150	4.5	0.9	1.3	10 ¹²	130角X22 t	
LMC-PN	白灰色 φ 50 μm加工	3.10	120	290	1.7	4.2	-	10 ¹⁴	180角X15	
LMC-ET	φ100 μm以上の加工 & 低熱膨張	2.46	61	140	2.6	5.8	1.4	10 ¹⁴	現210角、340角X15	-
L-TEX	Φ50 μm程度ポイドあり(白)	2.70		150		2.5	3.2	10 ¹³	375角	520角
AIN-250	窒化アルミ、高価	3.30	320	320	13	4.5	250	10 ¹³	120角X12t	
Si3N4-HIP	プローブカード用、レーザ加工	3.26	310	1000	14	3.5	23	10 ¹⁴	100角or150角X0.2~0.4	



Machinable Ceramics

LMC-PN 微細孔加工用 ($\phi 50\mu\text{m} \sim$)

白-灰色



LMC-ET $\phi 100\mu\text{m} \sim$ 孔加工用

白色

